

民生证券股份有限公司

关于

广东天承科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）



民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号）

二〇二二年九月

声 明

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“本保荐机构”）接受广东天承科技股份有限公司（以下简称“天承科技”、“公司”或“发行人”）的委托，担任其首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。

本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《科创板注册管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市保荐书内容与格式指引》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。

本上市保荐书如无特殊说明，相关用语具有与《广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义。

目 录

声 明	1
目 录	2
一、发行人基本情况	3
二、本次发行的基本情况	16
三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况	16
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明	17
五、保荐机构承诺事项	18
六、发行人关于本次证券发行履行的决策程序	19
七、关于发行人是否符合科创板定位的说明	19
八、关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的说明	23
八、对发行人持续督导期间的工作安排	24
九、保荐机构对本次股票上市的推荐意见	25

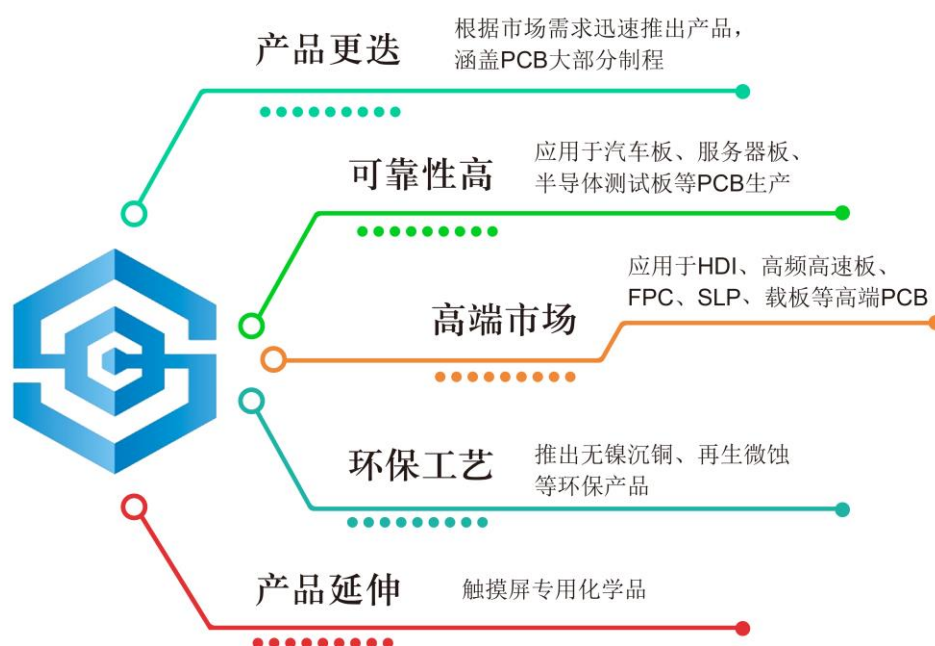
一、发行人基本情况

（一）发行人概况

中文名称	广东天承科技股份有限公司
英文名称	Guangdong Skychem Technology Co., Ltd.
注册资本	4,360.2694 万元
法定代表人	童茂军
成立日期	2010 年 11 月 19 日
整体变更日期	2020 年 11 月 9 日
住所	广东从化经济开发区太源路 8 号（厂房）首层
邮政编码	510990
电话号码	020-87818230
传真号码	020-87818230
互联网网址	http://www.skychemcn.com
电子信箱	public@skychemcn.com
投资者关系部门	董事会办公室
投资者关系负责人	董事会秘书 王晓花
投资者关系电话	020-87818230

（二）发行人主营业务

公司主要从事 PCB 所需要的专用电子化学品的研发、生产和销售。PCB 作为组装电子元器件和芯片封装用的基板，是电子产品的关键电子互连件，随着应用领域需求扩大和制造技术进步，PCB 产品类型由普通的单双面板和多层板发展出高频高速板、HDI、软硬结合板、类载板、半导体测试板、载板等高端产品。报告期内，公司产品主要应用于上述高端 PCB 的生产。



公司产品主要包括水平沉铜专用化学品、电镀专用化学品、铜面处理专用化学品等，应用于沉铜、电镀、棕化、粗化、退膜、微蚀、化学沉锡等多个生产环节。沉铜和电镀是 PCB 生产过程中重要的环节，是实现 PCB 导电性能的基础，间接影响电子设备的可靠性。随着终端领域的发展，PCB 的种类不断丰富，对沉铜和电镀专用化学品提出特殊的要求，HDI 板、类载板要求沉铜和电镀专用化学品对盲孔具有良好的处理能力以满足精细线路的制作要求；高频高速板、柔性电路板、载板的特殊材料要求沉铜专用化学品进行配方调整以产生良好的覆盖能力和结合力；汽车 PCB、服务器 PCB、半导体测试板等要求沉铜和电镀专用化学品的处理效果具有良好的热可靠性，能经受多次冷热冲击。

公司于 2012 年研发出水平沉铜专用化学品，报告期内主营业务收入占比平均为 71.66%，系公司的主要产品。根据客户需求，公司发展出多种水平沉铜系列产品，具有良好的可靠性以及稳定的制程能力，适合于盲孔、高纵横比通孔沉铜处理，并适用现行的高频高速基材和柔性电路板材料，能够有效满足客户生产高端 PCB 的要求。

公司于 2018 年研发出水平脉冲非析氧不溶性阳极盲孔电镀铜技术，该技术可应用于不溶性阳极电镀，解决了传统可溶性阳极的电镀均匀性不足和繁重

的阳极铜球保养问题。基于该项技术，公司开发出不溶性阳极水平脉冲电镀填孔产品，该产品对盲孔有良好的深镀能力，能有效降低表面镀铜层的厚度，并提高电镀效率，可以应用于多阶及任意层 HDI、类载板的生产。不溶性阳极水平脉冲电镀填孔产品长期被安美特所垄断，公司产品已在超毅电子、方正科技替换安美特部分产线进行量产。

（三）发行人核心技术

1、核心技术及先进性

经过多年来在行业内的积累，公司已经形成和拥有一系列具有自主知识产权的核心技术，在产品核心配方上拥有专利技术，具有技术优势。公司的核心技术权属清晰，并成熟运用于公司产品的批量生产中。

截至 2022 年 8 月 31 日，公司已取得 39 项发明专利，19 项实用新型专利，并形成了 PCB 水平沉铜产品制备及应用技术、封装载板沉铜产品制备及其应用技术、电镀铜产品制备及应用技术等多项核心技术，在主要产品中得到应用，具备将科技成果向现实生产力转化的能力。公司的水平沉铜专用电子化学品对 PCB 小孔、盲孔和高厚径比通孔有良好的处理能力，适用于高频高速板、HDI、多层软板及软硬结合板、类载板、半导体测试板等 PCB 的生产。2020 年，公司水平沉铜系列产品通过中国电子电路行业协会科技成果评审，评审会认为该项科技成果处于国内领先水平。

公司的不溶性阳极水平脉冲电镀填孔产品解决了传统可溶性阳极的电镀均匀性不足和繁重的铜球保养问题，可以应用于多阶及任意层互联 HDI、类载板的生产。2022 年，公司水平脉冲非析氧不溶性阳极盲孔电镀铜技术通过中国电子电路行业协会科技成果评审，评审会认为该项科技成果处于国内领先水平。

公司的主要核心技术取得的主要发明专利及在产品中的应用情况如下：

序号	核心技术名称	涉及发明专利	应用产品	阶段
----	--------	--------	------	----

1	PCB 水平沉铜产品制备及应用技术	一种非金属材料化学镀的活化溶液组合物 一种低钯化学镀铜活化剂及制备方法 化学铜药水中铜离子与甲醛浓度的快速测量方法 一种化学铜活化剂及制备方法 一种线路板的孔金属化工艺 一种电路板的无钯化学镀铜工艺 一种化学镀铜液 一种化学镀铜液 一种用于化学镀铜的活化液及其应用 一种浓缩型钯胶体及其制备方法和应用 一种 PCB 除胶后处理中和还原液及其制备方法和应用 一种化学镀铜液及其制备方法和盲孔处理方法 一种二价钯络合物溶液及其制备方法和应用	PCB 水平沉铜专用化学品	量产
2	封装基板沉铜产品制备及其应用技术	一种 ABF 表面处理剂及其制备方法和应用	封装基板沉铜专用化学品	小批量生产
3	触摸屏沉铜专用化学品制备及其应用技术	一种化学镀铜液及其制备方法和应用	触摸屏专用电子化学品	量产
4	电镀铜产品制备及应用技术	用于板型件表面填孔的电镀液及其电镀方法 电镀铜药水的效果评价方法 一种电镀液及其电镀方法 一种印刷电路板电镀装置及其电镀方法 一种电镀喷流系统 一种电镀液及其电镀方法和应用	电镀铜专用化学品	量产
5	电镀锡产品制备及应用技术	一种铜基金属表面浸锡液及其应用	电镀锡专用化学品	量产
6	铜面超粗化产品制备及应用技术	一种铜面有机酸型超粗化剂及制备方法 一种铜蚀刻液及其制备方法和应用	铜面超粗化专用化学品	量产
7	铜面中粗化产品制备及应用技术	铜面粗化微蚀刻剂 一种铜蚀刻液及其制备方法和应用	铜面中粗化专用化学品	量产
8	再生微蚀产品制备及应用技术	一种可循环再用铜和铜合金表面的微蚀刻化学处理药剂	再生微蚀专用化学品	量产
9	碱性微蚀产品制备及应用技术	-	碱性微蚀专用化学品	量产
10	棕化产品制备及应用技术	一种棕化液及其制备方法和应用	棕化专用化学品	量产
11	化学沉锡产品制备及应用技术	一种化学锡后处理溶液组合物 一种锡电镀液及其制备方法和应用	化学沉锡专用化学品	量产

2、重要奖项

公司自成立以来主要获得以下重要奖项：

序号	荣誉	授予单位	时间
1	水平脉冲非析氧不溶性阳极盲孔电镀铜技术被评审为国内领先水平	中国电子电路行业协会	2022年6月
2	SkyCopp 365X 系列水平沉铜药水和 SkyPlate Cu658 系列水平不溶性阳极脉冲填孔药水被评为 PCB 最佳贡献产品	广东省印制电子电路产业技术创新联盟，广东省电路板协会，深圳线路板协会	2021年10月
3	高可靠性水平沉铜技术被评审为国内领先水平	中国电子电路行业协会	2020年8月
4	第七届中国创新创业大赛全国总决赛新材料行业成长组三等奖	中国创新创业大赛组委会	2018年11月
5	第七届中国创新创业大赛（广东赛区）成长企业组新材料行业一等奖	中国创新创业大赛组委会广东赛区组委会	2018年6月

3、核心技术产品收入占主营业务收入的比重

报告期内，公司核心技术产品收入占营业收入比例情况如下表：

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
核心技术产品收入	7,657.59	32,166.50	21,345.74	14,458.86
营业收入	8,882.70	37,549.84	25,724.89	16,778.80
占比	86.21%	85.66%	82.98%	86.17%

注：占比=核心技术产品收入/营业收入

（四）发行人研发水平

1、专利情况

截至2022年8月31日，公司已经获得发明专利39项，实用新型专利19项。

2、研发支出情况

报告期，公司研发费用占营业收入的比例如下：

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
研发费用	581.27	2,131.82	1,428.05	964.55

营业收入	8,882.70	37,549.84	25,724.89	16,778.80
研发费用占营业收入比例	6.54%	5.68%	5.55%	5.75%

3、公司研发人员情况

(1) 核心技术人员、研发人员数量

截至 2022 年 3 月 31 日，公司共有研发人员 54 人，占公司员工总数的 30.51%，其中核心技术人员为刘江波、章晓冬和李晓红。公司高度重视对研发人才的吸引、培养与发展，确保研发团队稳定，为持续推出新产品、优化生产工艺及提升产品质量提供技术保障。

(2) 对核心技术人员实施的约束激励措施

公司与核心技术人员签署了《劳动合同》、《保密协议》，对其在任职期间内的工作职责、保密义务等做出了明确约定，以保证公司的合法权益。公司对核心技术人员进行了股权激励，同时提供具有市场竞争力的薪酬福利，充分调动员工对技术创新工作的主观能动性，有效促进公司技术的持续创新。

4、在研项目情况

截至 2022 年 3 月 31 日，公司正在从事的研发项目及进展情况具体如下：

序号	项目名称	研究内容和目标	进展	主要人员
1	载板 SAP 除胶和化学沉铜工艺及药水配方的研发	(1) 适用于先进封装载板技术的 ABF 材料的依赖于进口，并且供应紧张，因此国内多家公司正在开发可以替代 ABF 膜的载板绝缘膜。该研发项目旨在根据市场需求，配合载板厂和绝缘膜厂研发适用的沉铜产品。 (2) 玻璃材料具有良好的光学、电学、机械和化学稳定性，因此，玻璃基板在光学器件、射频和微波器件以及 MEMS 传感器等集成封装中具有广泛的应用。玻璃基板目前在表面形成导电层主要采用溅射技术，工艺难度和成本较高，沉铜技术作为替代技术成为业界目前研发重点。该研发项目旨在适用于玻璃通孔技术（TGV）的化学镀专用化学品，应用于玻璃基板的孔金属化制程。	小试阶段	章晓冬等
2	载板填通孔工艺电镀铜添加剂的研发	该研发项目旨在更高阶盲孔载板电镀技术的研发，例如 AR>0.8 的盲孔，同时侧重于研发应用于直通孔、X 孔及陶瓷板梯形孔填充的电镀技术，填充率目标为达到 90% 以上，以提高载板的互连可靠性，扩大产品的应用场景。	小试阶段	章晓冬等
3	适用 5G 高性能材料的孔金属化工艺的研发	目前的 5G 高频高速材料主要以进口材料为主，随着 5G 市场的发展，国内很多板材供应商正在不断开发新的 5G 材料，该研发项目旨在研究适用于新型高频高速材料的水平沉铜产品，主要测试板材为生益科技等公司推出的高频高速基材，未来还会根据新的高频高速基材的推出进行相关的技术研究。	中试阶段	李晓红等

4	载板填盲孔工艺电镀铜添加剂的研发	该研发项目旨在对目前公司的直流填孔电镀产品的升级, 拓宽产品的应用场景。研发目标为将 VCP 直流填孔电镀产品扩大应用场景, 包括应用在通孔电镀、盲孔填孔共镀工艺中、X 孔填充和直通孔填充, 并且在较高的电流密度 (2-3ASD) 下进行电镀。	中试阶段	林章清等
5	(VCP)不溶性阳极脉冲通孔电镀铜添加剂的研发	目前公司的氧化还原对溶铜技术主要应用在水平电镀上, 该研发项目旨在将氧化还原对溶铜技术应用在 VCP 脉冲电镀上, 实现行业技术的突破, 主要研发目标包括以下三个方面: (1) 对于高纵横比 (15:1 以上) 的线路板, 使用较低电流密度 (4-5ASD) 和较强的脉冲参数, 使得通孔的 TP 值达到 90% 以上; (2) 对于低纵横比 (8:1 以下) 的通孔线路板, 可以使用大电流密度 (5-7ASD) 进行生产, 大幅度提高生产线产能。	小量批测试	刘江波等
6	脉冲填孔电镀铜添加剂的研发	(1) 该研发项目旨在对现有的不溶性阳极水平脉冲电镀填孔产品的升级, 对于多种孔径比 (AR<0.8) 的盲孔板公司目前产品可以正常量产, 目前开发 AR>0.8 的盲孔和直通孔填充, 实现填充时间短、孔内无空心、面铜厚度薄等研发目标。 (2) 半导体垂直电互连技术 (TSV) 系 3D 集成封装关键技术, 主要通过铜等导电物质的填充完成硅通孔的垂直电气互连, 减小信号延迟, 降低电容、电感, 实现芯片的低功耗、高速通信, 增加带宽和实现器件集成的小型化需求。电镀铜系 TSV 技术的关键制程, 由于硅通孔及盲孔的纵横比较大, 需要从盲孔底部开始填充电镀铜, 给电镀制程带来挑战。该研发项目旨在通过运用公司在脉冲填孔上的技术积累, 开发出适用于半导体垂直电互连技术的电镀铜专用化学品。	中试阶段	章晓冬等
7	载板闪蚀工艺及添加剂的研发	载板线路细小, 一般采取 SAP 或 MSAP 的工艺, 需要闪蚀工序来完成对导电底铜的去除。该研发项目旨在研发适用于载板闪蚀的专用电子化学品, 能够提高蚀刻液中溶解氧的浓度, 加速 Cu ²⁺ 的再生, 提高 ORP 值和蚀刻速率, 并且能够调节蚀刻液中溶解氧的浓度, 实现蚀刻液 OPR 值和蚀刻速率保持稳定。	小试阶段	刘江波等
8	触摸屏网格金属化工艺研发	目前公司的金属网格沉铜技术可以制备线宽为 3-5 μ m 的金属铜网格, 该研发项目旨在持续改进用于金属网格的沉铜产品, 改善沉积铜的致密性和结合力, 满足更细网格线 (1-2 μ m) 的需求。	小试阶段	章晓冬等
9	适用 5G 低损耗要求铜面处理工艺的研发	5G 线路板的线路越来越细, 为满足阻抗控制的需要, 铜面处理要求不断提高, 该研发项目主要从两个方向开发适用 5G 低损耗的铜面处理专用化学品: (1) 对铜面超粗化技术进行升级, 研发目标为降低超粗化技术的微蚀量至 0.5 μ m, 同时能够形成相当的比表面积, 维持相当的结合力与可靠性。 (2) 不增加铜导体的粗糙度, 以化学键合的方式来提升铜导体与树脂之间的结合力, 避免因粗化而增加铜导体表面阻抗, 降低高频信号传输过程中的信号损失, 以满足 5G 等高频高速应用技术的需要。	小试阶段	刘江波等
10	适用 5G 高性能材料的水平化学镀锡工艺持续改善的研发	四价锡离子浓度高会产生沉淀等负面影响, 该研发项目旨在降低化学镀锡液中的四价锡离子浓度, 有效延长化学镀锡液的使用寿命, 降低成本。同时结合配方改进, 降低化学镀锡液的工作温度, 使其在 60 度左右运行, 减少化学镀锡对油墨的攻击, 减少油墨脱落的现象。	小试阶段	章晓冬等

11	可溶性阳极脉冲电镀铜添加剂的研发	该研发项目旨在研发适用于背板的脉冲电镀专用化学品。背板应用在通信和军工行业，孔纵横比可以高达 40:1 及以上，因此需要使用脉冲电镀技术才能达到电镀铜的工艺要求。该研发项目目标主要为：（1）良好深镀能力(TP)：AR=20:1，TP≥90%(单点)；AR=30:1，TP≥80%（单点）；AR=40:1，TP≥70%（单点）；（2）铜镀层结晶细致无柱状结晶；（3）电镀液的使用寿命≥500AH/L。	小试阶段	章晓冬等
12	直接电镀孔金属化系列产品的研发	该研发项目旨在目前直接电镀孔金属化产品的基础上，进一步优化碳孔液和聚孔通系列产品，包括适用 HDI 板、软硬结合板、IC 载板的碳孔液产品，适用 HDI 板的聚孔通产品，扩大其在孔金属领域的应用范围。	小试阶段	章晓冬等

（五）发行人主要经营和财务数据及指标

报告期内，发行人的主要财务数据及指标如下：

财务指标	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
资产总额（万元）	34,819.78	33,706.36	22,140.60	12,236.42
归属于母公司所有者权益（万元）	28,179.91	26,447.50	18,578.02	8,447.65
资产负债率（母公司）	16.56%	27.83%	21.03%	34.37%
营业收入（万元）	8,882.70	37,549.84	25,724.89	16,778.80
净利润（万元）	1,250.61	4,498.07	3,878.01	2,298.53
归属于母公司所有者的净利润（万元）	1,250.61	4,498.07	3,878.01	2,298.53
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	1,234.06	4,499.00	3,907.24	2,994.13
基本每股收益（元）	0.29	1.06	1.00	-
稀释每股收益（元）	0.29	1.06	1.00	-
加权平均净资产收益率	4.62	20.97	34.85	33.60
经营活动产生的现金流量净额（万元）	388.26	-472.74	1.05	-136.63
现金分红（万元）	1,000.00	-	3,000.00	-
研发投入占营业收入的比例	6.54%	5.68%	5.55%	5.75%

（六）发行人存在的主要风险

1、技术风险

（1）研发失败和成果转化风险

公司注重产品、技术的研发和创新，每年均投入大量研发经费用于研究开发新技术、新产品。公司由于新技术、新产品的研究开发过程及研发结果存在不确定性或因市场需求变化、市场预判不准确等原因导致相关研发技术不能形成产品或顺利实现产业化，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

（2）核心技术泄密风险

公司所处的 PCB 专用电子化学品行业具有较高的技术壁垒。在长期的研发与技术积累过程中，公司已经形成了专利技术以及核心配方、应用工艺等非专利技术相结合的技术体系，该技术体系对公司保证产品应用性能有着至关重要的作用。截至 2022 年 8 月 31 日，公司已取得 39 项发明专利，19 项实用新型专利。

如果公司未能对公司核心知识产权进行有效保密，导致个别人员出现工作疏忽、保管不善，或者出现任何侵犯公司专利或相关知情人士违反保密义务导致公司核心配方、应用工艺等非专利技术泄密的情形，可能对公司的持续盈利能力产生不利影响。

（3）核心技术人员流失风险

PCB 专用电子化学品企业的发展需要坚实的技术研发基础、不断的创新能力、积淀深厚的技术开发能力以及对下游行业发展的精确把握，因此公司核心技术人员对公司而言是公司发展的保证。公司核心技术人员在 PCB 专用电子化学品行业有多年的积累，具有丰富的产品研发经验以及技术开发经验，对公司的产品研发、技术进步具有重要的意义。

随着 PCB 专用电子化学品行业的不断发展，行业内企业对于人才的竞争也日趋激烈，公司无法排除核心技术人员流失的可能。如果公司无法保留核心技术人才，将对公司产品研发及技术开发带来不利影响。

2、经营风险

（1）宏观经济及下游市场需求波动带来的风险

报告期，公司主营业务为 PCB 专用电子化学品的研发、生产和销售，其发展与印制电路板的需求变动息息相关。印制电路板是电子产品的关键电子互连件，其发展与下游行业如计算机、通信设备、消费电子、汽车电子等领域联系密切，与全球宏观经济形势相关性较大。若全球经济增速放缓，印制电路板需求下降，将对公司的经营业绩产生不利影响。

（2）市场拓展风险

公司的主要竞争对手为安美特、陶氏杜邦、JCU、超特等企业，上述企业在品牌、资金和技术等方面均具有明显的优势，印制电路板等高端领域被其垄断多年，而电子化学品等产品又具有较强的服务黏性，公司面临无法显著地扩大市场份额的市场拓展风险。

（3）市场竞争加剧的风险

随着国家产业政策的持续推动、下游市场需求的不断扩大和行业技术水平的持续进步，PCB 专用电子化学品行业面临着良好的发展机遇，必然会有新的竞争对手加入进来，因此，预计国内市场的竞争程度也将日益激烈。由此，公司在与国际巨头争夺市场的同时，也会面临新的竞争对手的竞争威胁，如果公司不能根据市场需求持续开发新的产品，保持产品和技术竞争力，公司将存在不能与国际巨头企业进行有效竞争或者被后来竞争对手赶超的可能，从而对公司的市场地位、经营业绩造成不利影响。

（4）主要原材料价格波动的风险

报告期，原材料占公司主营业务成本的比例平均为 93.16%，是成本的主要构成部分。硫酸钯是公司的主要原材料，报告期内占公司主营业务成本的比例平均为 53.61%。硫酸钯价格受国际市场贵金属钯的影响较大，报告期内贵金属钯的市场价格快速上涨，使得公司原材料硫酸钯的采购价格快速上涨。

报告期内，在其他因素不变的情况下，硫酸钯的采购均价上涨 1%，则对公司利润总额的平均影响幅度为 2.21%，主要原材料的采购价格变动对公司的利润总额的影响较大。

公司向下游客户销售的水平沉铜专用化学品价格的调整频次和调整幅度与原材料硫酸钯的价格波动相比存在一定的滞后性，若未来公司主要原材料价格大幅增长，且公司不能及时通过向客户转移或者技术创新等方式应对价格上涨的压力，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

（5）公司因实际产量超过核定产能而受处罚的风险

报告期，天承科技和苏州天承的实际产量超过环评批复的产量，但天承科技和苏州天承没有因超产发生过安全事故，没有发生环境污染事件及事故，也

不存在因超标排放被监管部门处罚的情形。为解决上述超产生产的问题，公司设立子公司上海天承，并于 2021 年 9 月试运行，天承科技和苏州天承的产能转移至上海天承生产，2022 年以来上海天承主要负责 PCB 专用电子化学品的生产，公司已解决超环评批复的产量生产。公司超产生产目前虽然未受到相关部门的处罚，但可能存在对公司进行处罚的情形，若处罚对公司生产经营造成不利影响。

（6）环境保护风险

公司产品的生产工艺主要为配方型复配工艺，生产过程是化学原料的混合，不涉及合成反应，工艺较为简单，污染物排放较少，主要包括以废酸、废碱、含铜废液、硫酸雾等为主要污染物成分的废水、废气等。针对生产过程中产生的污染物，发行人已经取得了相应的排放许可证、建造了配套的污染物处理设施，制定了相关的环保制度并持续进行环保投入，能够确保污染物的达标排放。报告期内，公司不存在因环境违法而受到当地生态环境部门行政处罚的情况。但是，随着公司业务规模的不断扩大，公司废气、废水、固废的排放量可能会相应增加，如果公司的环保治理、“三废”排放不能满足监管要求，将可能导致公司受到罚款、停限产等监管措施，从而对公司的生产经营造成不利影响。

（7）房产租赁风险

公司目前无自有房产，生产经营所需的办公用房及厂房均系租赁所得。公司与出租方已签订租赁合同，且公司租赁的房产普遍具有较高的可替代性，但如果出现租赁期间因偶发性因素导致租赁提前终止、厂房租赁到期无法续约、到期后无法迅速找到合适的替代厂房或是其他影响租赁厂房正常使用的情形，可能会对公司短期内日常经营业务的开展造成不利影响。

3、内控风险

（1）控制权风险

公司实际控制人童茂军直接持有公司 19.51%的股份，通过广州道添间接控制公司 21.70%的股份，童茂军实际支配公司 41.21%的股份表决权，公司发行

上市后，童茂军实际支配公司的表决权比例下降至 30.91%，童茂军对公司的控制权会有所下降，未来可能出现导致公司控制权不稳定的情况，进而影响公司经营政策的稳定性和连续性。

（2）管理风险

本次发行完成后，公司资产规模将迅速扩大，对公司生产经营活动相关的各方面管理都提出了更高要求。如果公司管理层的业务素质、管理水平及管理力量不能适应公司规模快速扩大的需要，组织架构和管理制度未能随着公司规模扩大而及时、相应的调整和完善，将给公司带来较大的内控风险。

4、财务风险

（1）毛利率波动风险

报告期，公司主要产品为 PCB 专用电子化学品，占主营业务收入的比例平均为 99.87%，公司 PCB 专用电子化学品的毛利率分别为 43.49%、31.95%、28.21%和 31.93%，存在一定的波动。2020 年和 2021 年公司 PCB 专用电子化学品的毛利率下降，由于原材料硫酸钯的采购价格快速上涨，同时受疫情影响和公司发展战略考虑，销售均价的涨幅低于销售成本的涨幅。2022 年 1-3 月，公司 PCB 专用电子化学品的毛利率上升，由于主要原材料硫酸钯的采购价格下降、产品结构调整等。

报告期内，在其他因素不变的情况下，硫酸钯的采购均价上涨 1%，则公司 PCB 专用电子化学品的毛利率将变动 0.31%、0.38%、0.39%、0.33%，主要原材料的采购价格变动对公司 PCB 专用电子化学品的毛利率的影响较大。如果未来公司的经营规模、产品结构、客户资源、成本控制等方面发生较大变动，导致公司产品销售价格、原材料价格或客户的需求发生较大的变化，公司将面临主营业务毛利率波动的风险。

（2）应收账款坏账风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 7,148.42 万元、8,919.35 万元、13,935.73 万元和 14,082.58 万元，占同期流动资产的比例分别为 62.33%、42.18%、50.14%和 48.56%，占比较高。随着公司业务规模扩大，若下游客户财务状况、

经营情况发生重大不利变化，公司将面临应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的风险，将会对公司的经营业绩和资金状况产生负面影响。

（3）经营活动现金流量净额低于净利润的风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别-136.63万元、1.05万元、-472.74万元和388.26万元，同期净利润分别为2,298.53万元、3,878.01万元、4,498.07万元和1,250.61万元，公司经营活动产生的现金流量净额低于同期净利润水平，主要原因是公司客户的账期相对较长，且使用银行承兑汇票结算比例较大；同时，随着公司收入规模增加，客户包线数量增加，存货规模相应增加，占用的流动资金较大，经营活动产生的当期现金流量净额低于净利润。如果未来公司在业务发展中经营活动产生的现金流量净额持续低于净利润，将对公司营运资金的正常周转产生不利影响。

（4）存货余额增大的风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为2,049.35万元、2,842.80万元、4,610.61万元和5,709.05万元，占流动资产的比例分别为17.87%、13.44%、16.59%和19.69%。随着公司生产规模的不断扩大，未来存货余额可能进一步增加。公司已依据审慎原则，对可能发生跌价损失的存货足额计提了存货跌价准备。但如果下游行业发生不利变化或产品出现滞销等情况，公司将面临存货积压及跌价风险，给公司经营和财务状况带来不利影响。

（5）净资产收益率下降风险

报告期，公司按照属于公司普通股股东净利润计算的加权平均净资产收益率分别为33.60%、34.85%、20.97%和4.62%。本次发行后，公司净资产和总资产规模将大幅增长，而募集资金投资项目从投入到产生效益需要一定的时间，公司存在净资产收益率下降风险。

5、发行失败风险

公司在中国证监会同意注册决定启动发行后，如存在发行人预计发行后总市值不满足招股书中明确选择的市值与财务指标上市标准，或者存在首次公开发行股票网下投资者申购数量低于网下初始发行量等其他《上海证券交易所科

科创板股票发行与承销实施办法》中规定的中止发行的情形，发行人将面临发行失败的风险。

6、募集资金项目未能实现预期效果风险

公司本次募集资金将用于“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”、“研发中心建设项目”和“补充流动资金”。其中，年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目主要基于未来公司业务持续发展和下游产业需求增加的预期，若未来市场发生不可预见的变化，或者公司不能有效开拓新市场等其他对产品销售不利的因素，公司将存在新增产能难以消化，募集资金投资项目无法实现预期盈利的风险。

二、本次发行的基本情况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	不超过 14,534,232 股
发行方式	采用向保荐人相关子公司定向战略配售、网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或采用证监会和上交所规定的其他方式
每股面值	人民币 1.00 元
发行后总股本	不超过 58,136,926 股
拟上市证券交易所	上海证券交易所
拟上市板块	科创板
保荐人（主承销商）	民生证券股份有限公司

三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

（一）保荐代表人

民生证券指定曾文强、帖晓东作为发行人首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人。

本次发行的保荐代表人主要执业情况如下：

曾文强：保荐代表人，2011年开始从事投资银行工作，2017年注册为保荐代表人。曾主持和参与了兴蓉投资配股、金轮股份IPO、兴森科技非公开发行、景旺电子IPO、盛弘股份IPO、景旺电子可转债、四会富仕IPO、雷尔伟IPO、威尔高IPO等项目，以及多家公司的改制辅导工作，具有丰富的投资银行业务经验。

帖晓东：保荐代表人，注册会计师，现任民生证券投资银行事业部高级经理。2018年开始从事投资银行业务，曾参与北清环能重大资产重组、天源环保IPO、兴森科技非公开发行股票、威尔高IPO等项目，以及多家公司的尽职调查及前期辅导工作。

（二）项目协办人

本次发行的项目协办人主要执业情况如下：

黄颂歌：注册会计师，现任民生证券投资银行事业部高级经理。2020年开始从事投资银行业务，曾参与威尔高IPO、兴森科技非公开发行股票等项目，以及多家公司的尽职调查及前期辅导工作。

（三）项目组其他成员

发行人首次公开发行股票并在科创板上市项目的项目组其他成员为廖思琦、梁宗元、林熙妍、刘江奇。

四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

民生证券自查后确认：

（一）本保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）发行人及其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不

存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况；

（四）本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况；

（五）本保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。

五、保荐机构承诺事项

本保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，做出如下承诺：

（一）本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本上市保荐书；

（二）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、上海证券交易所所有关证券发行并上市的相关规定；

（三）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（四）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（五）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与其他证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（六）保荐代表人及项目组其他成员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（七）上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（八）对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

（九）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施。

六、发行人关于本次证券发行履行的决策程序

（一）董事会决策程序

发行人已于 2022 年 7 月 16 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》等与本次发行上市相关的议案，并提请股东大会批准。

（二）股东大会决策程序

2022 年 8 月 3 日，发行人召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市方案的议案》等与本次发行上市相关的议案。

七、关于发行人是否符合科创板定位的说明

（一）符合科创板推荐行业范围

公司主营业务为 PCB 专用电子化学品的研发、生产和销售。根据中国证监会颁布实施的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，本公司所属行业为化学原料及化学制品制造业（代码 C26）。根据国家统计局 2017 年修订的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，本公司所属行业为电子元件及电子专用材料制造（代码 C398）下属的电子专用材料制造（C3985）。

根据国务院 2016 年 11 月颁布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，公司主营业务和主要产品属于“三、促进高端装备与新材料产业突破发展，引领中国制造新跨越”中“专栏 10 新材料提质和协同应用工程”中的“电子信息用化学品”。根据国家统计局 2018 年 11 月颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》（国家统计局令第 23 号），公司属于“3.3 先进石化化工新材料”之“3.3.6.0 专用化学品及材料制造(C3985 电子专用材料制造)”。

（二）公司掌握先进核心技术并具有产业化能力

1、发行人主要核心技术情况

经过多年来在行业内的积累，公司已经形成和拥有一系列具有自主知识产

权的核心技术，在产品核心配方上拥有专利技术，具有技术优势。公司的核心技术权属清晰，并成熟运用于公司产品的批量生产中。

截至 2022 年 8 月 31 日，公司已取得 39 项发明专利，19 项实用新型专利，并形成了 PCB 水平沉铜产品制备及应用技术、封装载板沉铜产品制备及其应用技术、电镀铜产品制备及应用技术等多项核心技术，在主要产品中得到应用，具备将科技成果向现实生产力转化的能力。公司的水平沉铜专用电子化学品对 PCB 小孔、盲孔和高厚径比通孔有良好的处理能力，适用于高频高速板、HDI、多层软板及软硬结合板、类载板、半导体测试板等 PCB 的生产。2020 年，公司水平沉铜系列产品通过中国电子电路行业协会科技成果评审，评审会认为该项科技成果处于国内领先水平。

公司的不溶性阳极水平脉冲电镀填孔产品解决了传统可溶性阳极的电镀均匀性不足和繁重的铜球保养问题，可以应用于多阶及任意层互联 HDI、类载板的生产。2022 年，公司水平脉冲非析氧不溶性阳极盲孔电镀铜技术通过中国电子电路行业协会科技成果评审，评审会认为该项科技成果处于国内领先水平。

2、核心技术取得的主要发明专利及其在产品中的应用情况

截至 2022 年 8 月 31 日，公司已取得 39 项发明专利，19 项实用新型专利。公司的主要核心技术取得的主要发明专利及在产品中的应用情况如下：

序号	核心技术名称	涉及发明专利	应用产品	阶段
1	PCB 水平沉铜产品制备及应用技术	一种非金属材料化学镀的活化溶液组合物 一种低钯化学镀铜活化剂及制备方法 化学铜药水中铜离子与甲醛浓度的快速测量方法 一种化学铜活化剂及制备方法 一种线路板的孔金属化工艺 一种电路板的无钯化学镀铜工艺 一种化学镀铜液 一种化学镀铜液 一种用于化学镀铜的活化液及其应用 一种浓缩型钯胶体及其制备方法和应用 一种 PCB 除胶后处理中和还原液及其制备方法和应用 一种化学镀铜液及其制备方法和盲孔处理方法 一种二价钯络合物溶液及其制备方法和应用	PCB 水平沉铜专用化学品	量产

2	封装基板沉铜产品制备及其应用技术	一种 ABF 表面处理剂及其制备方法和应用	封装基板沉铜专用化学品	小批量生产
3	触摸屏沉铜专用化学品制备及其应用技术	一种化学镀铜液及其制备方法和应用	触摸屏专用电子化学品	量产
4	电镀铜产品制备及其应用技术	用于板型件表面填孔的电镀液及其电镀方法 电镀铜药水的效果评价方法 一种电镀液及其电镀方法 一种印刷电路板电镀装置及其电镀方法 一种电镀喷流系统 一种电镀液及其电镀方法和应用	电镀铜专用化学品	量产
5	电镀锡产品制备及其应用技术	一种铜基金属表面浸锡液及其应用	电镀锡专用化学品	量产
6	铜面超粗化产品制备及其应用技术	一种铜面有机酸型超粗化剂及制备方法 一种铜蚀刻液及其制备方法和应用	铜面超粗化专用化学品	量产
7	铜面中粗化产品制备及其应用技术	铜面粗化微蚀刻剂 一种铜蚀刻液及其制备方法和应用	铜面中粗化专用化学品	量产
8	再生微蚀产品制备及其应用技术	一种可循环再用铜和铜合金表面的微蚀刻化学处理药剂	再生微蚀专用化学品	量产
9	碱性微蚀产品制备及其应用技术	-	碱性微蚀专用化学品	量产
10	棕化产品制备及其应用技术	一种棕化液及其制备方法和应用	棕化专用化学品	量产
11	化学沉锡产品制备及其应用技术	一种化学锡后处理溶液组合物 一种锡电镀液及其制备方法和应用	化学沉锡专用化学品	量产

3、与核心技术相关的获奖情况和论文发表情况

(1) 重要获奖情况

公司自成立以来主要获得以下重要奖项：

序号	荣誉	授予单位	时间
1	水平脉冲非析氧不溶性阳极盲孔电镀铜技术被评审为国内领先水平	中国电子电路行业协会	2022年6月
2	SkyCopp 365X 系列水平沉铜药水和 SkyPlate Cu658 系列水平不溶性阳极脉冲填孔药水被评为 PCB 最佳贡献产品	广东省印制电子电路产业技术创新联盟，广东省电路板协会，深圳线路板协会	2021年10月

3	高可靠性水平沉铜技术被评审为国内领先水平	中国电子电路行业协会	2020年8月
4	第七届中国创新创业大赛全国总决赛新材料行业成长组三等奖	中国创新创业大赛组委会	2018年11月
5	第七届中国创新创业大赛（广东赛区）成长企业组新材料行业一等奖	中国创新创业大赛组委会广东赛区组委会	2018年6月

（2）论文发表情况

公司就核心技术及通过核心技术研发的产品、工艺发表了多篇论文，具体情况如下：

序号	论文成果	发布期刊	发布时间	作者
1	一种采用不溶性阳极板的印制电路板酸性电镀铜技术	印制电路信息	2021年	李晓红等
2	一种硫酸-双氧水微蚀剂对悬铜消除效果的研究	印制电路信息	2020年	林章清等
3	一种新型增强多层板内层结合力的方法	印制电路信息	2020年	黄建东等
4	一种挠性PCB化学镀铜液	印制电路信息	2019年	李晓红等
5	背光法观测电镀锡层孔隙率方法的研究	印制电路信息	2019年	章晓冬等
6	一种快速褪除铜和锡的环保型退挂架液	印制电路信息	2019年	林章清等

4、核心技术产品产业化情况

公司依托核心技术开发了水平沉铜专用化学品、电镀专用化学品等产品，并在多个客户实现量产应用。公司的水平沉铜专用化学品已经在深南电路、景旺电子、方正科技、崇达技术、博敏电子等公司中实现了大规模应用；电镀专用化学品已经在超毅电子、方正科技、定颖电子、中京电子、博敏电子等公司中实现了量产应用；铜面处理专用化学品、棕化专用化学品等已经在深南电路、景旺电子、定颖电子、方正科技、信泰电子、奥特斯等公司中实现了量产应用；封装基板沉铜专用化学品已经在中国科学院微电子所、江阴芯智联电子科技有限公司实现了应用；触摸屏专用电子化学品已经在江苏软讯科技有限公司实现了应用。

报告期，公司核心技术产品收入逐年增长，占营业收入比例情况如下表：

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年	2020年	2019年
核心技术产品收入	7,657.59	32,166.50	21,345.74	14,458.86
营业收入	8,882.70	37,549.84	25,724.89	16,778.80

占比	86.21%	85.66%	82.98%	86.17%
----	--------	--------	--------	--------

（三）公司符合科创属性评价指标的要求

参照中国证监会发布的《科创属性评价指引（试行）》及《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》的相关规定，公司有关科创属性具体评价指标体系的情况具体如下：

1、最近三年，公司研发投入分别为 964.55 万元、1,428.05 万元、2,131.82 万元，最近三年研发投入金额合计 4,524.42 万元，累计占营业收入的比重为 5.65%，公司符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第一款与《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第五条第一款规定。

2、截至 2022 年 3 月 31 日，公司研发人员共有 54 人，占公司员工总数的 30.51%，符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第二款与《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第五条第二款规定。

3、截至 2022 年 3 月 31 日，公司及子公司累计取得发明专利 36 项，并通过产品销售形成主营业务收入，符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第三款与《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第五条第三款规定。

4、最近三年，公司营业收入分别为 16,778.80 万元、25,724.89 万元、37,549.84 万元，最近 3 年营业收入复合增长率 49.60%，符合《科创属性评价指引（试行）》第一条第四款与《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第五条第四款规定。

八、关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的说明

（一）发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条第（二）项规定

本次发行前，公司总股本为 43,602,694 股，发行后总股本不超过 58,136,926 股，符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（二）发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元”规定。

（二）发行人符合《上市规则》第 2.1.1 条第（三）项规定

根据发行人 2022 年第三次临时股东大会批准的关于发行人本次发行上市的决议，发行人本次发行不超过 14,534,232 股，占公司发行后总股本的比例不低于 25%，符合《上市规则》第 2.1.1 条之“（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上”规定。

（三）发行人市值及财务指标符合《上市规则》规定的标准

公司选择适用《上市规则》第 2.1.2 条第（一）项上市标准：“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

公司 2020 年、2021 年归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）分别为 3,878.01 万元、4,498.07 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 5,000 万元。公司最近一次增资估值为 13.80 亿元，预计发行后总市值不低于 10 亿元，能够满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第一款标准中的市值标准。

八、对发行人持续督导期间的工作安排

事项	工作安排
（一）持续督导事项	在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后三个完整会计年度内对发行人进行持续督导
1、督导发行人有效执行并完善防止大股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度	强化发行人严格执行中国证监会有关规定的意识，协助发行人制订、执行有关制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，确保保荐机构对发行人关联交易事项的知情权，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
2、督导发行人有效执行并完善防止高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，协助发行人完善有关制度，并督导发行人有效实施；与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	督导发行人尽可能避免和减少关联交易，若有关的关联交易为发行人日常经营所必须或者无法避免，督导发行人按照《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定执行，对重大的关联交易，保荐机构将按照公平、独立的原则发表意见；发行人因关联交易事项召开董事会、股东大会的，应事先通知保荐机构，保荐机构可派保

	荐代表人列席相关会议并提出意见和建议
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	关注并审阅发行人的定期及不定期报告；关注新闻媒体涉及公司的报道；督导发行人履行信息披露义务，督促发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露的规定
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、募集资金运用情况	定期跟踪了解项目进展情况，查阅募集资金专户中的资金使用情况，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	督导发行人遵守《公司章程》、《对外担保管理制度》以及中国证监会关于对外担保行为的相关规定
7、持续关注发行人经营环境和业务状况、股权变动和管理状况、市场营销、核心技术以及财务状况	与发行人建立经常性信息沟通机制，及时获取发行人的相关信息
8、根据监管规定，在必要时对发行人进行现场检查	定期或者不定期对发行人进行回访，查阅所需的相关材料并进行实地专项核查
(二) 保荐与承销协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	有权要求发行人按照证券发行上市保荐有关规定和保荐协议约定的方式，向保荐机构及其保荐代表人通报与履行保荐职责相关的信息和资料；按照中国证监会、证券交易所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明
(三) 发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定	发行人及其高级管理人员应协调发行人的大股东、实际控制人和其他关联方以及为发行人提供专业服务的中介机构及其签名人员与保荐机构及其保荐代表人之间的关系，使其协助保荐机构及其保荐代表人及时、准确、充分地了解、获取与履行保荐职责有关的真实信息和资料；发行人及其高级管理人员应按保荐协议约定的方式向保荐机构通报、提供与履行保荐职责相关的信息和资料，为保荐机构、保荐代表人及保荐机构所聘请的中介机构人员履行保荐职责提供必要的条件和便利；保荐机构对其他中介机构及其签名人员所出具的专业意见存有疑义时，可以与中介机构进行协商，并可要求其做出解释或者出具依据
(四) 其他安排	无

九、保荐机构对本次股票上市的推荐意见

在充分尽职调查、审慎核查的基础上，本保荐机构认为：本次广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所有关规定；民生证券同意保荐广东天承科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市。

(以下无正文)

(此页无正文,为《民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签章页)

项目协办人: 黄颂歌
黄颂歌

保荐代表人: 曾文强 帖晓东
曾文强 帖晓东

内核负责人: 袁志和
袁志和

保荐业务负责人: 王学春
王学春

总经理(代行): 熊雷鸣
熊雷鸣

董事长、法定代表人(代行): 景忠
景忠

